



(0,80mm) .0315"

HSEC8-EM, DEC8 系列



边缘封装 EDGE RATE™ 卡插座

技术规格

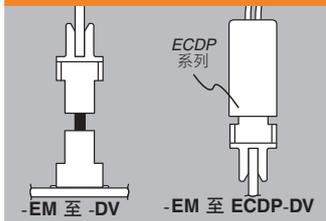
如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?HSEC8-EM

绝缘体材料:
液晶聚合物
触点: 镀铜
电镀: 在 50μ" (1,27μm) 的镍上镀金或锡
额定电流:
30°C 温升时为 3.1A (详情参见网站。)
工作温度:
-55°C 至 +125°C
卡插入深度:
(3,15mm) .125" 标称
可无铅焊接:
是
符合 RoHS 规范要求:
是



注: 所需的 PCB 厚度为 (1,60mm) .062" ±(0,08mm) .003"

应用



HSEC8

1

每排位置数

01

电镀选项

D

EM2

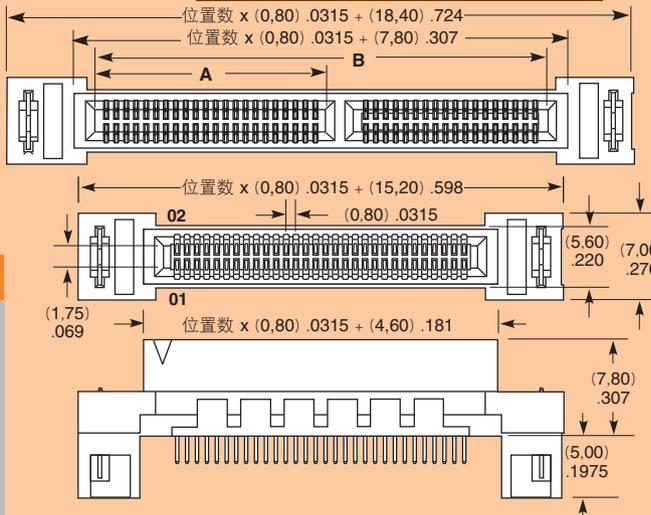
配接:
(1,60mm) 0.62" 厚度的卡、ECDP、HSC8、HSF8

10, 20, 30, 40, 50, 60

-L
= 触点镀 10μ" (0,25μm) 的金, 焊尾镀雾锡

-EM2
= (1,60mm) .062" 厚度的 PCB

注: 提供其他镀金选项。请联系 Samtec。



每排位置数	A	B
40	(18,90) .744	(36,60) 1.441
50	(22,90) .902	(44,60) 1.756
60	(26,90) 1.059	(52,60) 2.071

还提供

有电极标记, 用于与 ECDP 系列双轴线缆配接

连接器	线缆
HSEC8-113	ECDP-08
HSEC8-125	ECDP-16
HSEC8-137	ECDP-24
HSEC8-149	ECDP-32

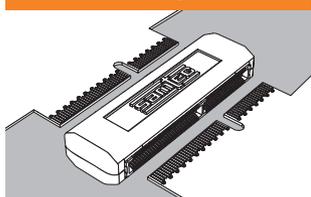
技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?DEC8

绝缘体材料:
黑色 ABS
触点: 镀铜
电镀: 在 50μ" (1,27μm) 的镍上镀金或锡
额定电流:
在 95°C 至 125°C 时为 3.1A (详情参见网站。)
工作温度:
-55°C 至 +125°C
符合 RoHS 规范要求: 是



应用



注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。

DEC8

1

每排位置数

引线式样

电镀

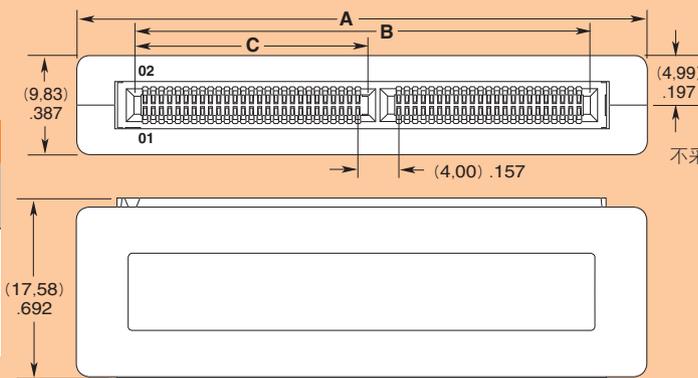
配接:
(1,60mm) .062" 厚度的卡、HSC8

40, 50, 60

-01
= (1,60) .062" 卡厚度

-S
= 触点镀 30μ" (0,76μm) 的金

注: 提供其他镀金选项。请联系 Samtec。



不采用模制品, 实现透明性

每排位置数	A	B	C
40	(47,75) 1.880	(36,60) 1.441	(18,90) .744
50	(55,75) 2.195	(44,60) 1.756	(22,91) .902
60	(63,75) 2.510	(52,60) 2.071	(26,90) 1.059